



ADVANCED LINK TECHNOLOGY

반도체 분야에서 뛰어난 기술력과 경험을 바탕으로
끊임없이 미래에 도전합니다.



Investor Relations 2024

Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사에이엘티(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드리는 바입니다.

본 Presentation에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며 제한 사항에 대한 위반은 관련 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함)

본 문서는 주식 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

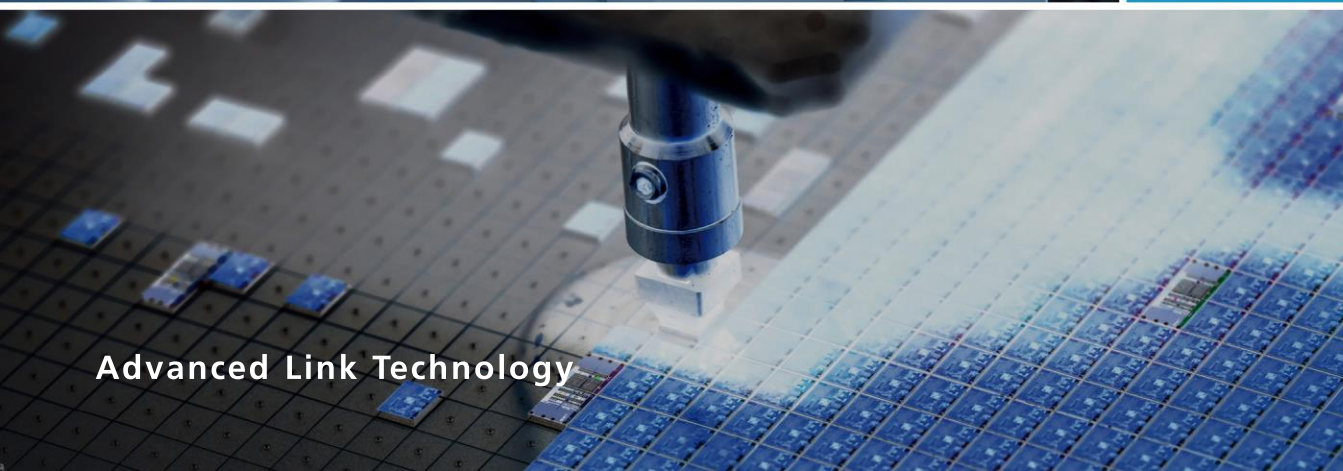


CHAPTER
01



Earning Review

1. 2024년 2분기 실적
2. 투자현황



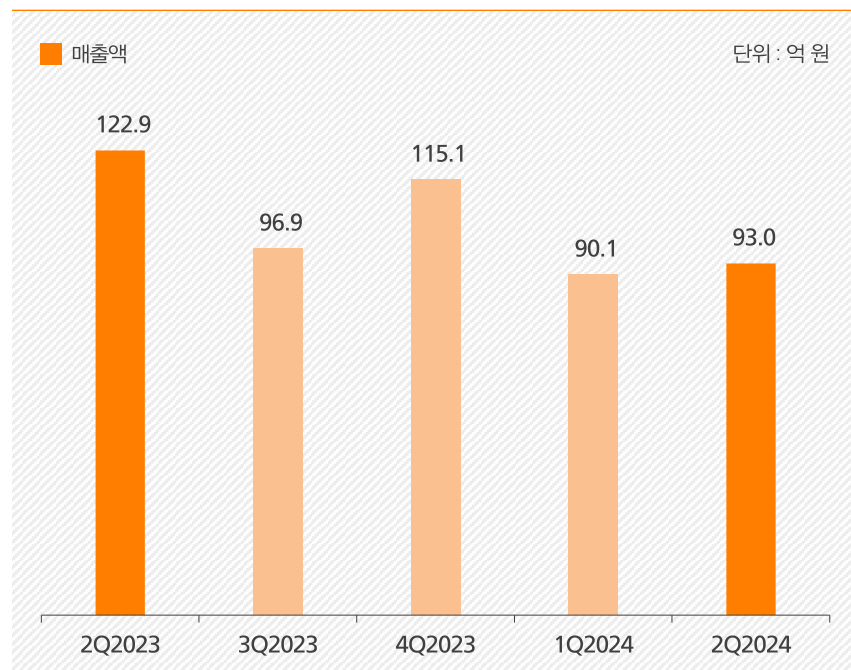
01

2024년 2분기 실적

DDI, CIS 중심의 전방 수요 위축으로 2Q23 대비 매출액 -24.3% 감소

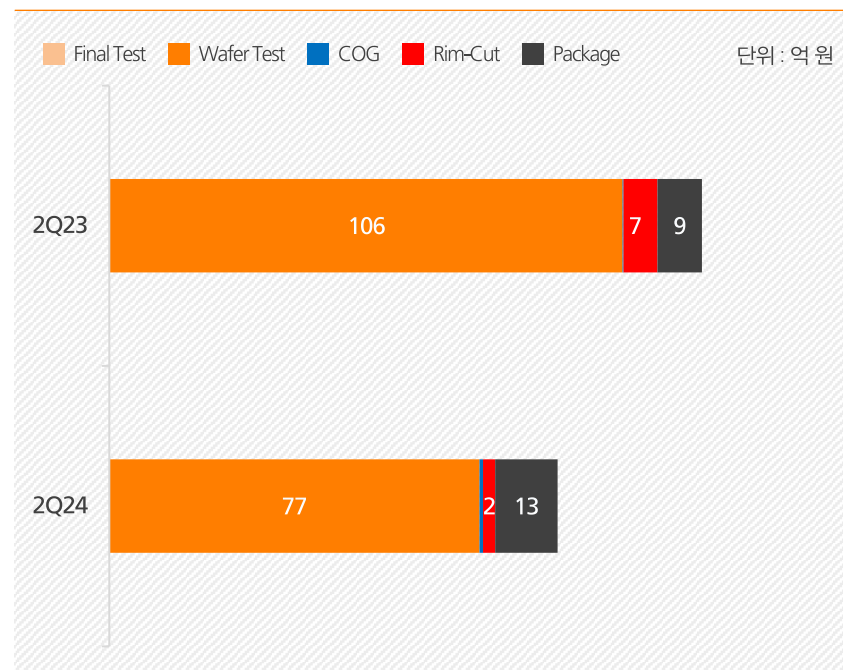
- » Wafer Test: 전년동기 대비, DDI(-42.6억, -59.4%), CIS(-11.6억, -62.8%) 매출 감소
M/C(24.9억) 매출 신규 발생

매출액 추이



주: K-IFRS 연결 기준

전년동기 대비 사업부별 매출액





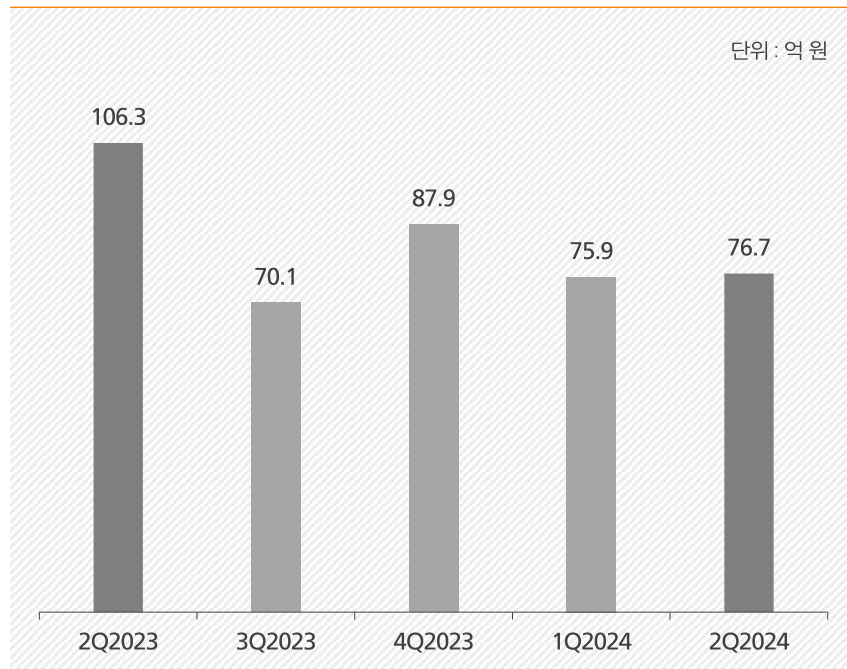
2024년 2분기 실적

전방수요 감소로 주요 테스트 품목 매출 감소했으나, M/C 매출 증가세 지속

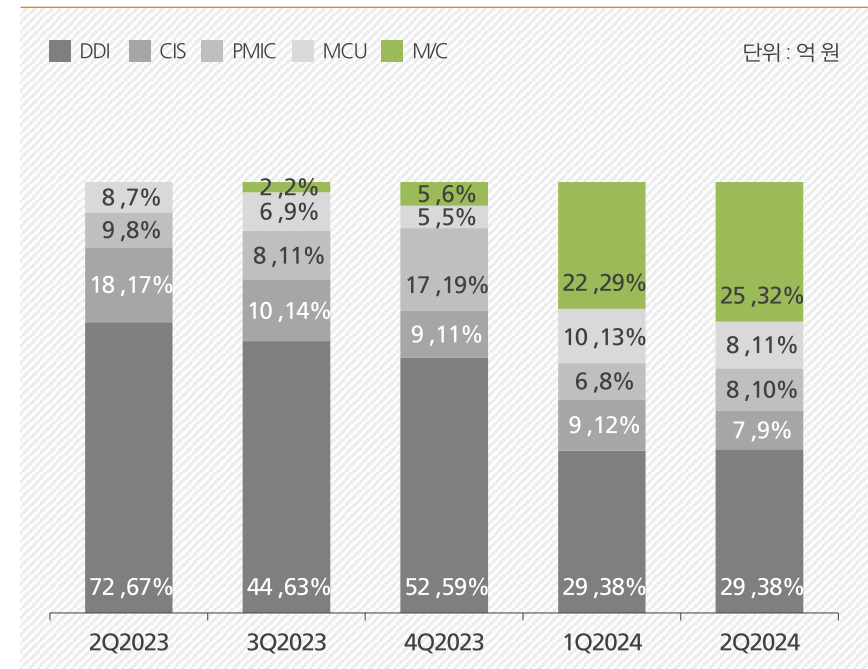


- » DDI, CIS: 전년동기 대비, 모바일향 전방수요 감소로 인해 매출액 감소
- » M/C: 3Q23 개시된 M/C 테스트 설비의 가동률 향상 및 메모리 업황 개선으로 인한 매출액 증가

Wafer Test 매출 추이



Wafer Test 매출 비중 추이





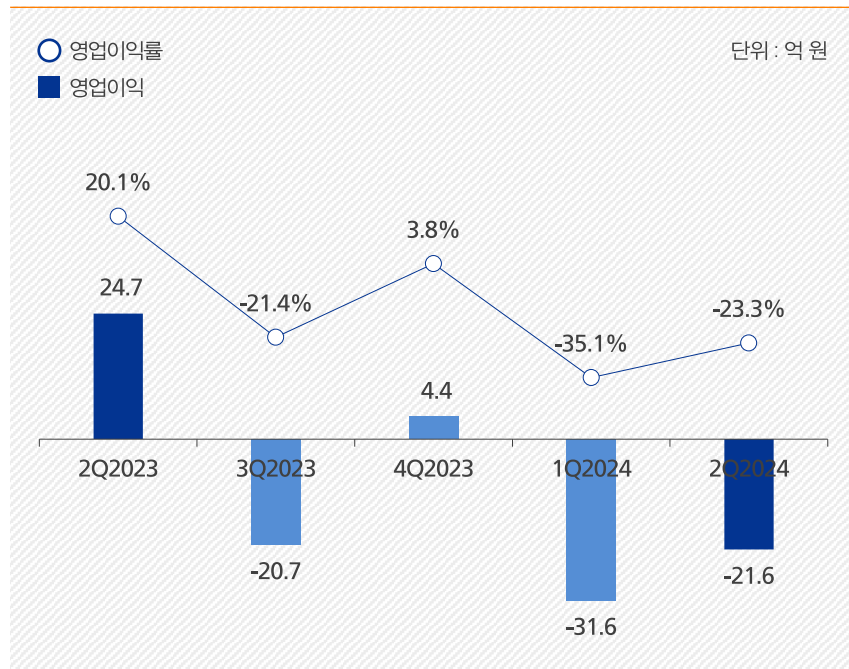
2024년 2분기 실적



설비 도입에 따른 영업비용 증가와 영업외손익 기저효과에 따른 이익률 하락

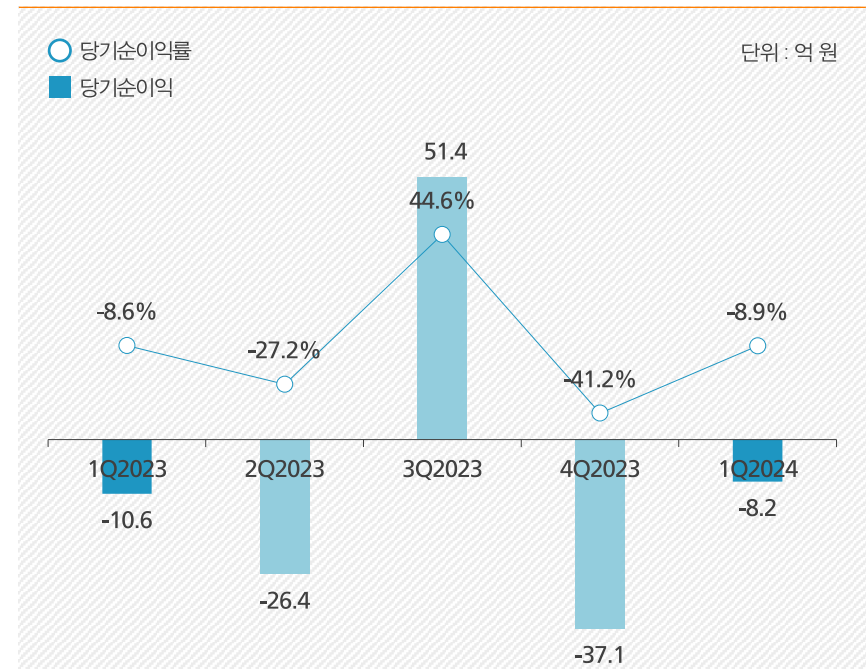
- » 영업비용 증가: 전년동기 대비, M/C 등 설비 증설에 따른 감가상각비(+10.0억)와 전력비·인건비(+6.3억원) 등 비용 증가
- » 금융비용 감소: 전년동기 상장에 따른 CB평가손실(36.8억) 반영 기저효과 발생
- » 법인세 환급: 유형자산 투자에 따라 당분기 법인세 환급(21.5억, +17.5억 QoQ)효과 반영

영업이익(률)



주: K-IFRS 연결 기준

당기순이익(률)



02

투자현황

CB 발행을 통한 200억원 자금조달 완료, 연내 M/C설비 증설 완료 예정

- » '24.6월, CB 발행을 통해 시설자금, 채무상환용 자금 200억원 조달 완료(전환가액 25,500원, Refixing 없음)
- » 조달자금 중 시설자금(M/C 설비 증설) 83억원, 채무상환 50억원 집행 완료, 3Q 내 시설자금 67억원 집행 완료 예정

M/C 테스트 장비 증설



신공장 건설

- M/C, CIS, AP 등 테스트 CAPA 확대를 위한 신공장 부지 매입 ('24.04.11 신규시설투자등)
- '24 연내 착공 목표로 설계 중. '25년 공장 준공(1차 1,144억원 규모 CAPA 확보) '26년 양산 목표

A close-up photograph of a microchip or integrated circuit. The chip is rectangular and has a dense array of gold-colored pins or solder balls protruding from its surface. The background is dark and out of focus.

CHAPTER
02

A decorative graphic element on an orange background. It consists of several thin, white, curved lines that sweep upwards and to the right, creating a sense of motion or a stylized 'A' shape.

Company Overview

1. 사업영역
2. ALT 비메모리 반도체 공정 영역
3. 다양한 고객사 확보

매출분야

Test
(Wafer Test, Final Test)Test 후가공
(P&P(CoG, Recon), Rim-Cut)

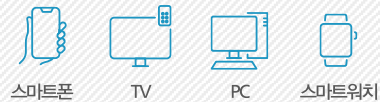
Packaging

ALT 주요 비메모리 반도체

DDI (Display Driver IC)

각종 LCD Panel, LED, OLED 등을
구동 시키는 반도체 소자

적용 산업



CIS (CMOS Image Sensor)

빛에너지를 전기적인 신호로 변환하는
집적회로가 내장된 이미지 센서

적용 산업



PM-IC (IGBT 등)

전자기기에 필요한 전력 공급 및
효율적 관리

적용 산업



MCU / SoC

전자기기에 채택되는 통합 칩(SoC)
단순 동작부터 AI 등 다양한 특성을 제어

적용 산업



M/C (Memory Controller)

메모리를 관리, 제어하고
효율적인 데이터 처리를 지원하는 칩

적용 산업



AP (Application Processor)

모바일 기기와 임베디드 시스템의
다양한 작업을 처리하는 통합 프로세서

적용 산업



ALT 비메모리 반도체 공정 영역

비메모리 반도체 후공정 토탈 솔루션 제공

전공정

후공정

Wafer Test

Dicing / P&P

Assembly(Packaging)

Final Test

Final Product

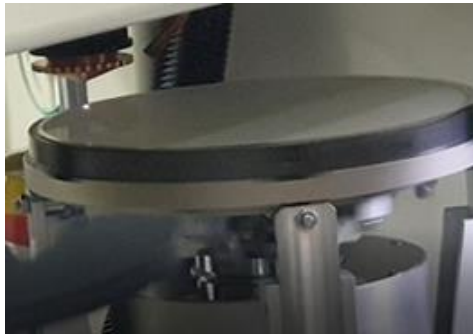
사업 내용	웨이퍼 상태에서 양품/불량 판정	웨이퍼 절단 및 양품 재배열	패키징 공정	최종 출하 전 양품 판정
적용 제품	DDI	Rim cut 웨이퍼 레이저 절단	 자회사 (주)에이지피 진행 CIS Wafer Test + Packaging OSAT 서비스 제공	DDI
	CIS	IGBT		
	PM-IC (IGBT 등)	COG 양품 재배열		
	MCU / SoC	DDI		
	M/C	Recon Chip 불량 여부 파악 (신규사업)		
	AP	CIS		

다양한 고객사 확보

ALT만의 차별화된 기술 제공으로 다양한 고객사 확보

국내 유일 Rim-Cut 솔루션 제공

Laser Cut 방식의 Taiko Wafer 절단 프로세스를 자동화된 단일 공정으로 통합, Chip 수율을 향상시키는 국내 유일 솔루션

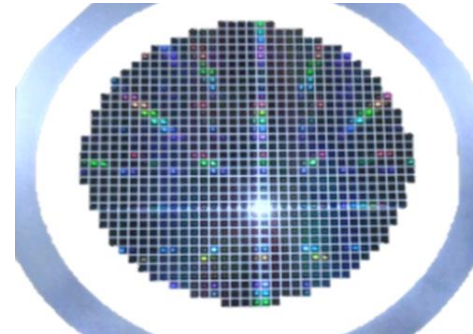


열, 스크랩에 의한 불량 감소
수율 극대화

단일 공정을 통한
납기 단축

Recon Turn-Key 서비스 제공

Wafer Test와 함께 절단 및 분리, 양품 Chip을 성능별로 재배열하는 Turn-Key 서비스 제공



고품질 생산 시스템 구축

신속한 후속 공정 지원

주요 고객사 현황

SAMSUNG

SK hynix

Littelfuse
Expertise Applied | Answers Delivered

nejes

POWERMASTER
SEMICONDUCTOR

ABOV
SEMICONDUCTOR

Magnachip

STECO

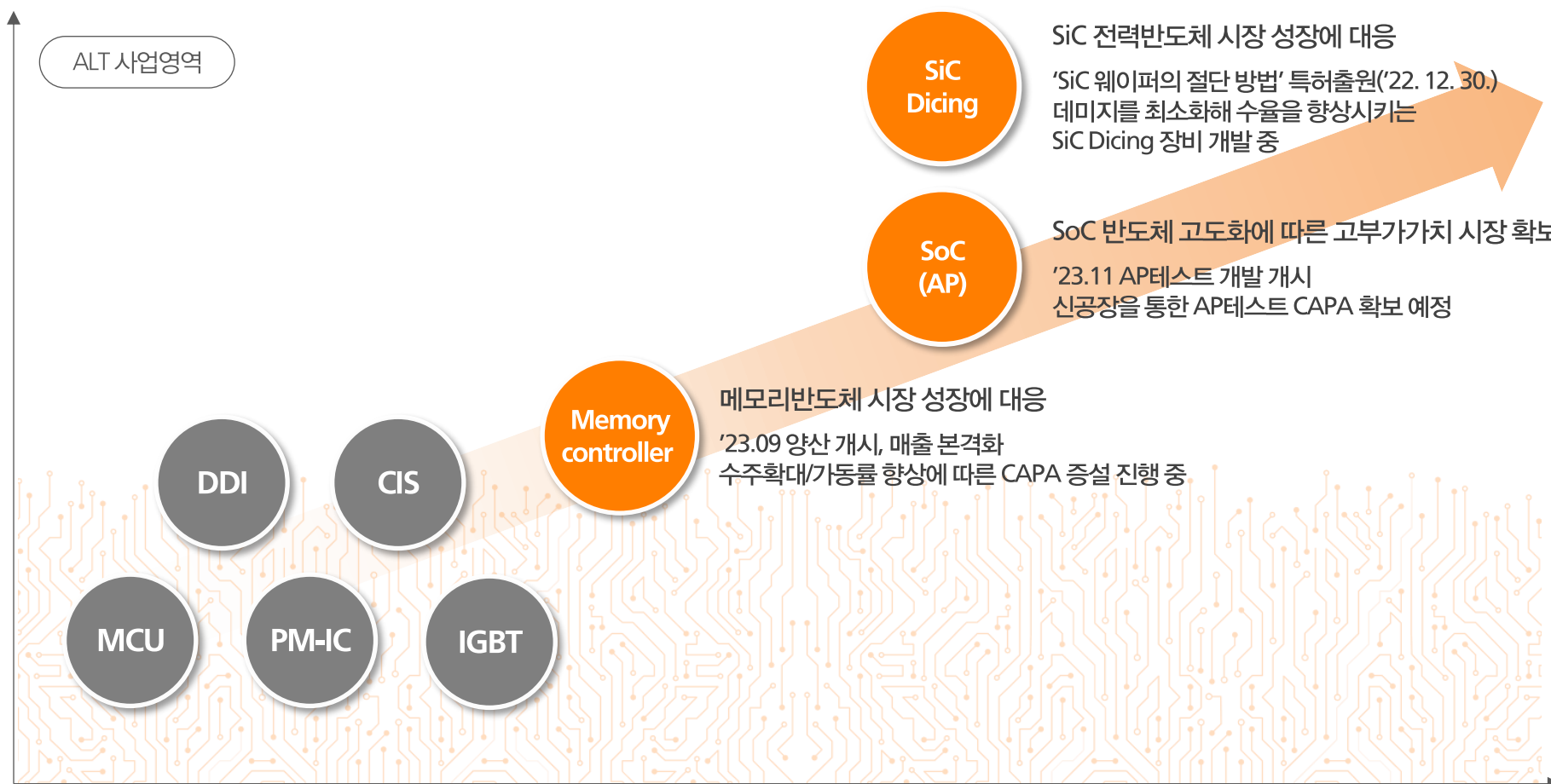
LB Lusem

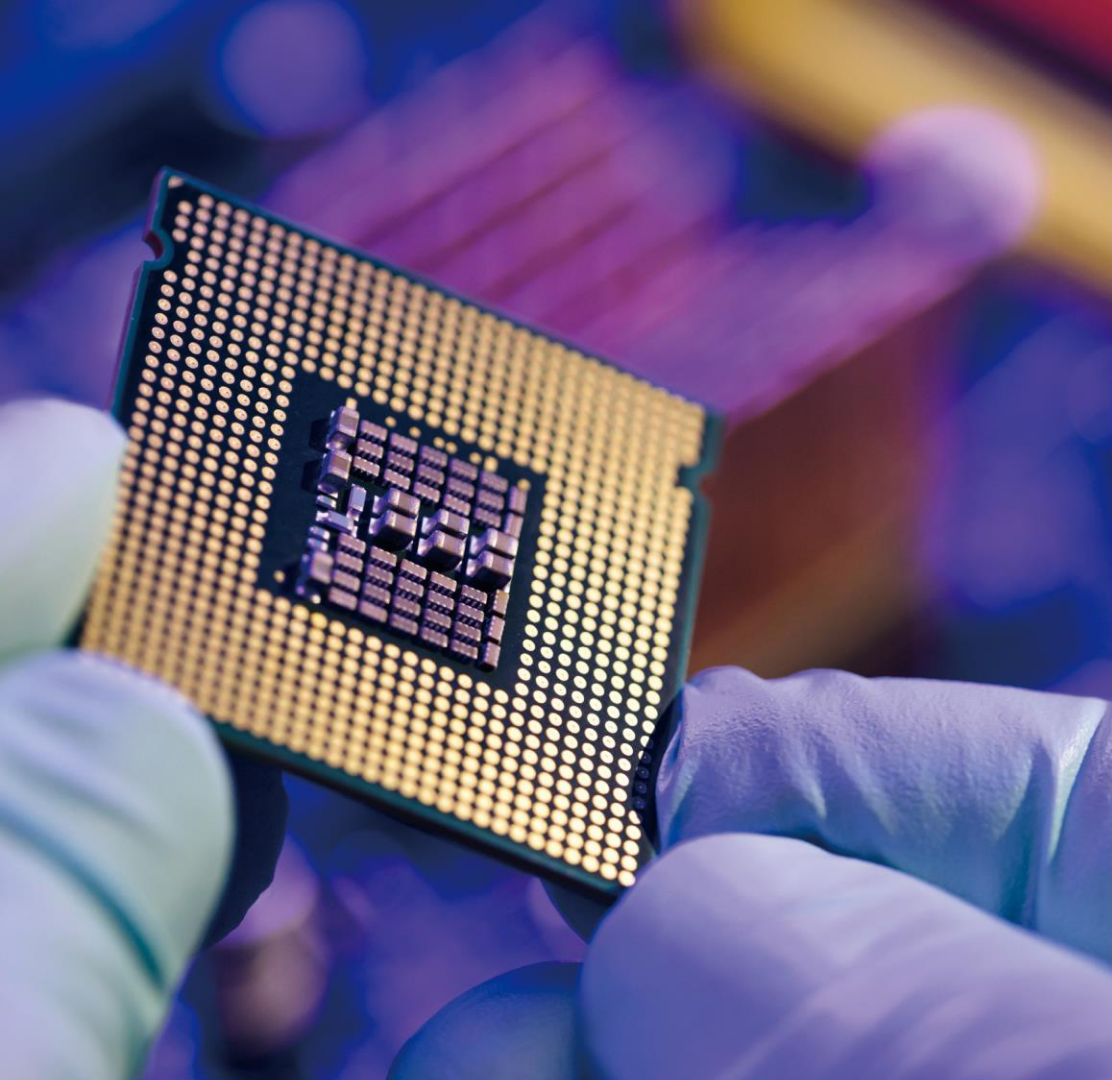
LB Semicon

PIXELPLUS

신규 사업영역 확장

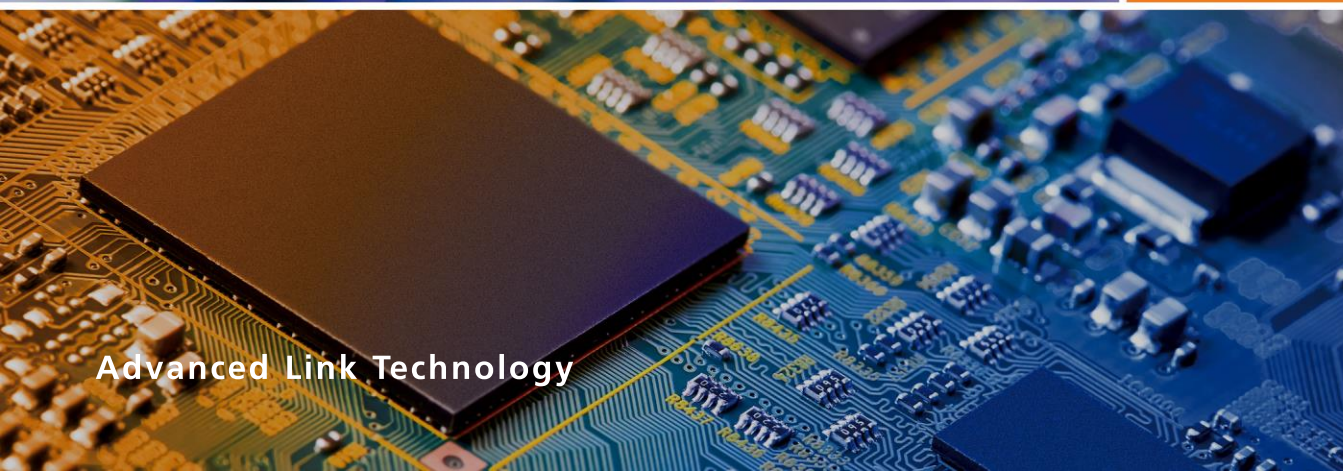
Memory Controller, SoC 등 고부가가치 테스트 품목으로 사업영역 다변화





Appendix

1. 회사 개요
2. 회사 연혁
3. 공정 소개
4. 2023년 연간 실적
5. 요약 재무제표



기업개요

회사명	(주) 에이엘티
대표이사	이덕형
설립일	2003년 7월 23일
자본금	44.8억 원
본점소재지	충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19
홈페이지	www.alt-s.kr

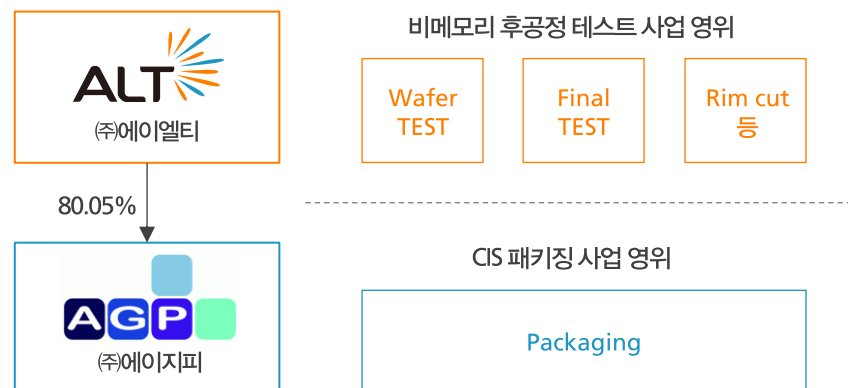
대표이사



이덕형 CEO

- 서울대학교 물리학과 졸업, 이학박사
- 삼성전자(주) 근무 27년
- 삼성전자(주) 전무이사 역임
- LSI 공정개발 및 생산 총괄
- 삼성종합기술원 이미지 소자 랩장/ 전무이사 역임
- 스테코(주) 근무 3년
- 스테코(주) 대표이사 역임
- 現 ALT 대표이사

지배구조 및 사업영역



회사 연혁

비메모리 반도체 포트폴리오가 다변화된 OSAT 전문기업으로 성장 중

사업기반 구축
(2003~2013)

- 2003**
 - 07월 에이엘티세미콘(주) 설립 (자본금22.5억)
 - 08월 2003년 (주)하이닉스 MOU체결
- 2004**
 - 03월 공장준공 (오창과학산업단지)
 - 06월 기업부설연구소 인가
- 2005**
 - 04월 CIS(CMOS Image Sensor) 양산시작
- 2006**
 - 10월 삼성전자(주) 물품공급계약 체결
 - 11월 (주)루셈 물품공급계약 체결
- 2007**
 - 12월 SK하이닉스(주) CIS 양산 시작
- 2008**
 - 07월 건물 2,890평 증축 준공
- 2009**
 - 05월 Magna Chip 외 P/T 양산
- 2013**
 - 07월 회사명 변경
(에이엘티세미콘(주) → (주)에이엘티)

사업 고도화 및 성장기
(2014~2020)

- 2015**
 - 01월 스테코 DDI 양산 시작
 - 03월 제 49회 납세자의 날
성실납세자 대통령 표창
 - 09월 CIS T2000 설비 투자 및 양산 시작
- 2016**
 - 03월 DDI 12인치 Wafer P/T 양산 시작
- 2018**
 - 11월 삼성 PM-IC(Wafer Test) 양산 시작
- 2019**
 - 10월 제16회 충청북도 중소기업대상
수출대상
- 2020**
 - 02월 SK하이닉스 CIS 300mm(64para) 선정
 - 08월 중소벤처기업공단 K-예비유니콘
유망기업
 - 08월 신규 Biz COG 양산 시작

도약기
(2021~)

- 2021**
 - 03월 ISO 14001:2015 인증 획득
 - 04월 IATF 16949:2016 인증 획득
- 2022**
 - 03월 삼성 DDI, EDS P검 Biz 시작
 - 09월 삼성 Memory controller P검
설비투자
- 2023**
 - 07월 코스닥시장 상장
 - 11월 ESG 경영인증서 획득

Wafer Test

Dicing / P&P

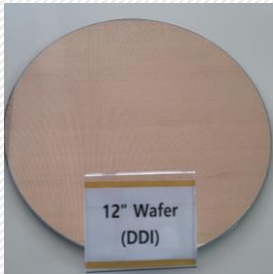
Assembly(Packaging)

Final Test

Final Product

Probe Test Process

Wafer 상태의 Chip의 양품 선별공정으로, Chip의 불량 식별 및 설계상의 문제점을 발견해 개선하는 공정으로,
반도체 수율 향상을 위해 반드시 필요한 솔루션



DDI Wafer

웨이퍼 투입

Prober에 투입, 자동검사

적용제품
DDI, CIS, PM-IC, M/C, AP,
MCU/SoC 등



TEST LINE



TESTER+PROBER



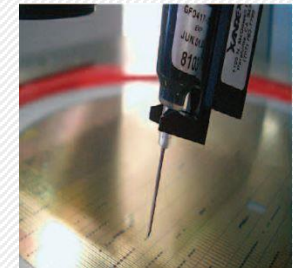
PROBER



AVI

AVI 검사

외관상 이물, 기타 특이사항
검사



INKING

잉킹

불량 칩에 잉크로 표시

공정 소개 ② Ring(Rim) Cut

PM-IC(IGBT 등) 웨이퍼 테스트 및 국내 유일 Rim Cut 기술을 Turnkey로 제공

Wafer Test

Dicing / P&P

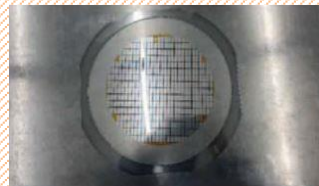
Assembly(Packaging)

Final Test

Final Product

Ring(Rim) Cut Solution

국내 최초로 Laser Cut 방식을 도입, Kerfwidth 최소화로 Net Die 손실을 줄이는 Taiko Wafer 테두리 절단 분리 솔루션



Full Auto System

5개 공정을 1개 공정으로 단축, Handling 과정에서 발생하는 Wafer Damage 발생 근본적으로 해소



Taiko Wafer

Wafer 안쪽을 얇게(70 μ m) 갈아내고,
테두리는 두껍게 남겨놓는 가공공법

Blade Saw

절단폭이 넓어 Net Die 수량 감소
파편에 의한 Chip 손상으로 수율 감소

Laser Cut

절단폭 최소화, Net Die 최대화
열손상 및 파편에 의한 Chip 손실 예방

공정 소개 ③Recon(CIS 등)

양품 체크 및 성능별 칩 재배열 기술을 Turnkey로 제공해 사업 확장 실현

Wafer Test

Dicing / P&P

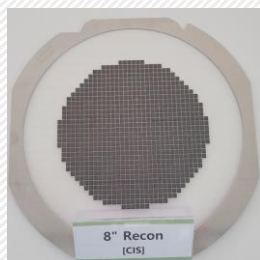
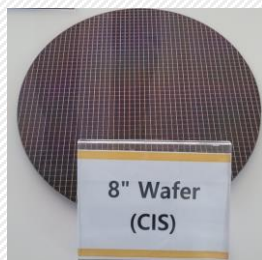
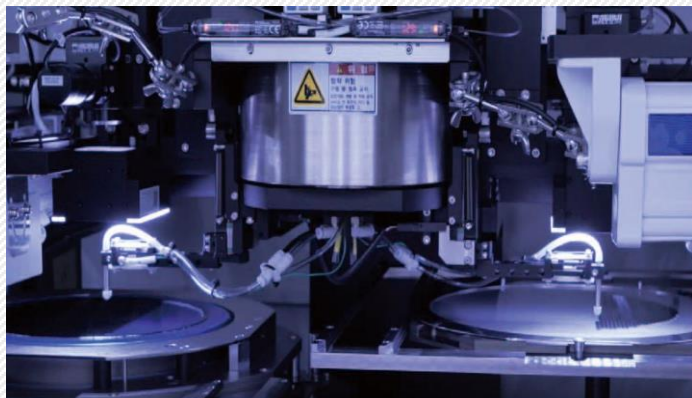
Assembly(Packaging)

Final Test

Final Product

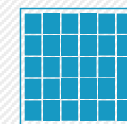
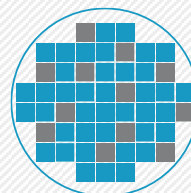
Recon: Wafer Reconstruction

Sawing 후 양품 Chip을 Pick Up하여 고객 요청에 맞추어
Wafer 형태로 테이프에 재배치하는 솔루션



COG

DDI칩 Sawing 후 고객이 원하는 양품칩만을 Tray에 재배열



■ 양품 chip
■ 불량 chip

Wafer 사이즈별 재배열

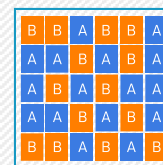
8인치, 12인치 웨이퍼,
*경박단소 필요제품 재배열 가능

고품질 생산 시스템 구축

Turnkey 서비스 제공
생산 표준화 MES 시스템 구축

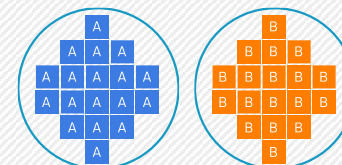
Recon

Wafer Test 후 선별된 양품 Chip 성능별 구분 및 재배열



성능별 Chip 재배열

빠른 후속 공정 가능



One Stop 솔루션 제공

Test - Back Grinding
- Sawing - Recon

공정 소개 ④Package

CLCC(고신뢰성 세라믹 패키지), PLCC(플라스틱 패키지) 조립 및 테스트 공정

Wafer Test

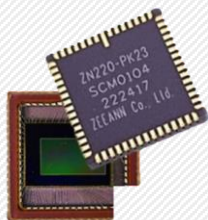
Dicing / P&P

Assembly(Packaging)

Final Test

Final Product

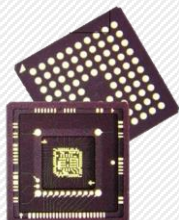
Automotive & Military Sensor



CLCC
일반용



A_BGA
전장 및 방산용



MCP
멀티칩

CIS

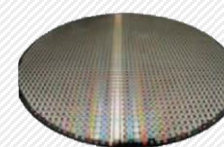
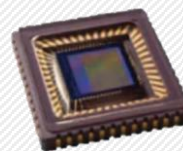
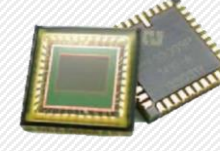


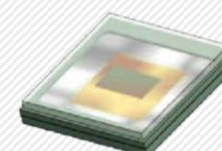
IMAGE SENSOR WAFER



CLCC
세라믹 바디



PLCC
플라스틱 바디



BGA
볼 리드

Appilcation

AUTOMOTIVE



SECURITY



PC CAM



DIGITAL CAM



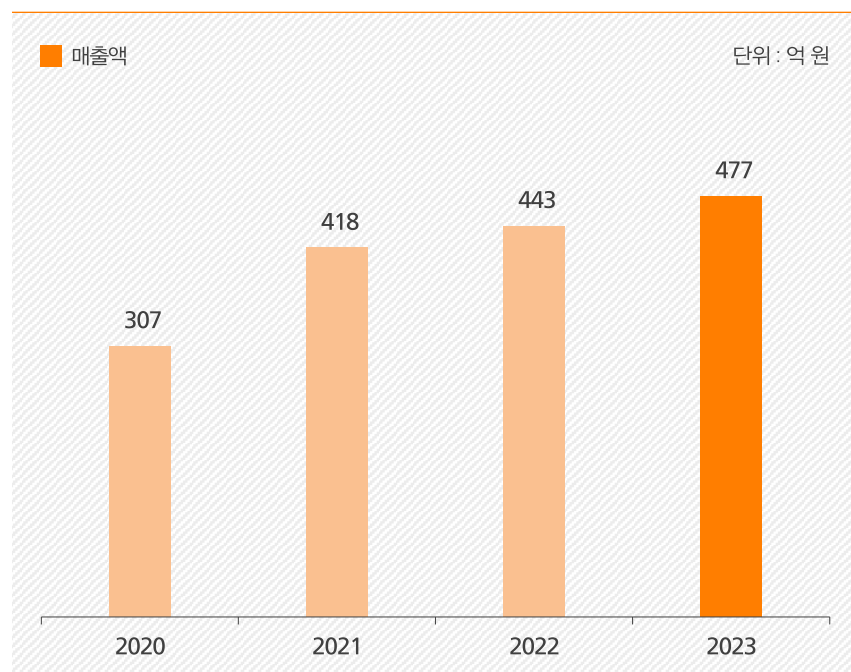
2023년 연간 실적



매출액은 Wafer Test와 Rim-Cut 매출 상승으로 전년 대비 7.6% 증가한 477억원 기록

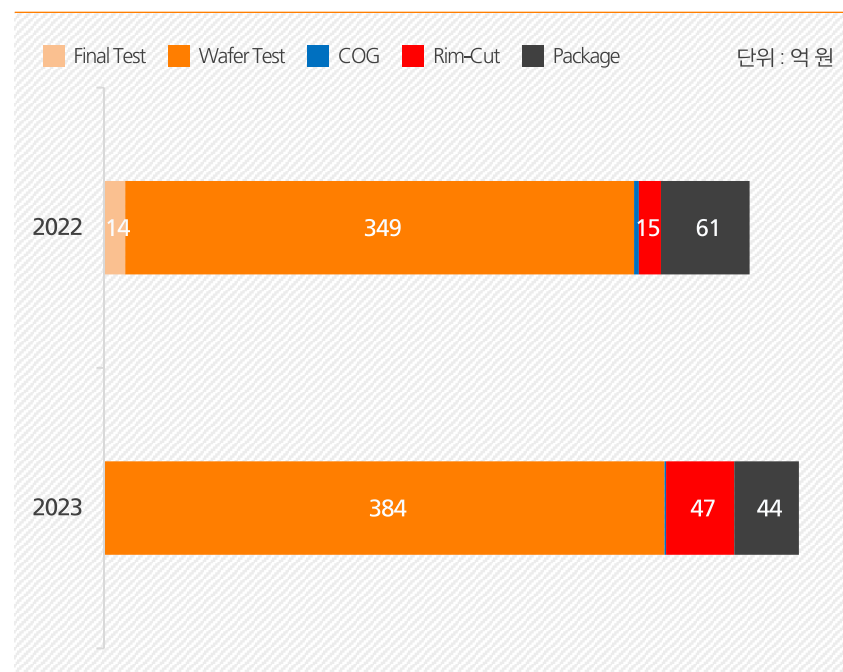
- » Wafer Test: 상반기 주요고객사 호조로 DDI 매출 큰 폭 증가(+105.4억, +73.9%), M/C 매출 9월부터 일부 발생(6.5억원) CIS(-59.8억, -48.7%)는 고객사 제품 런칭 지연 등으로 매출 감소
- » Rim-Cut: 고객사 수주 확대에 따라 +31.7억, +209.3%

매출액



주: K-IFRS 연결 기준

전년 대비 사업부별 매출액





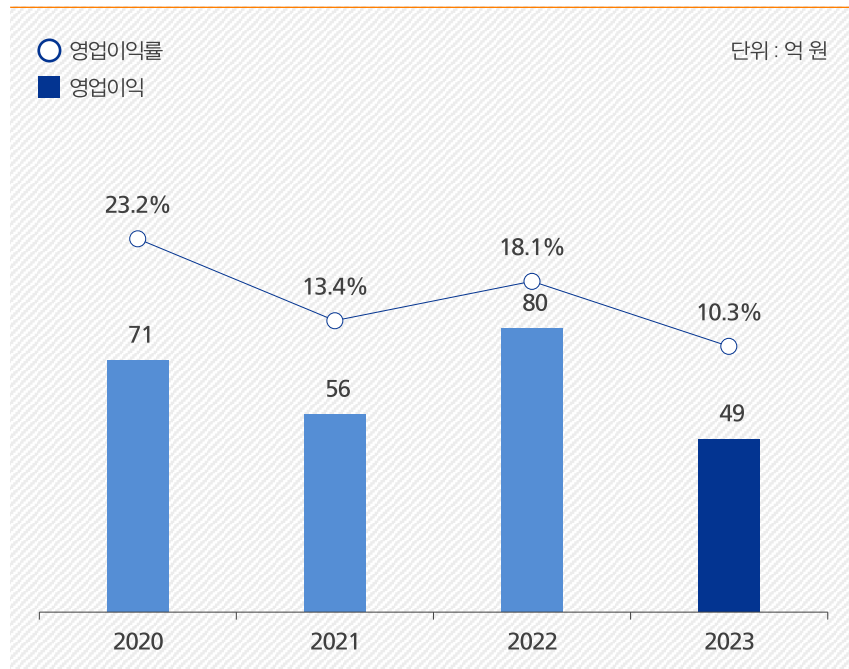
2023년 연간 실적



설비 도입에 따른 영업비용 증가, 영업외 일시적 손실 반영에 따른 당기순이익 하락

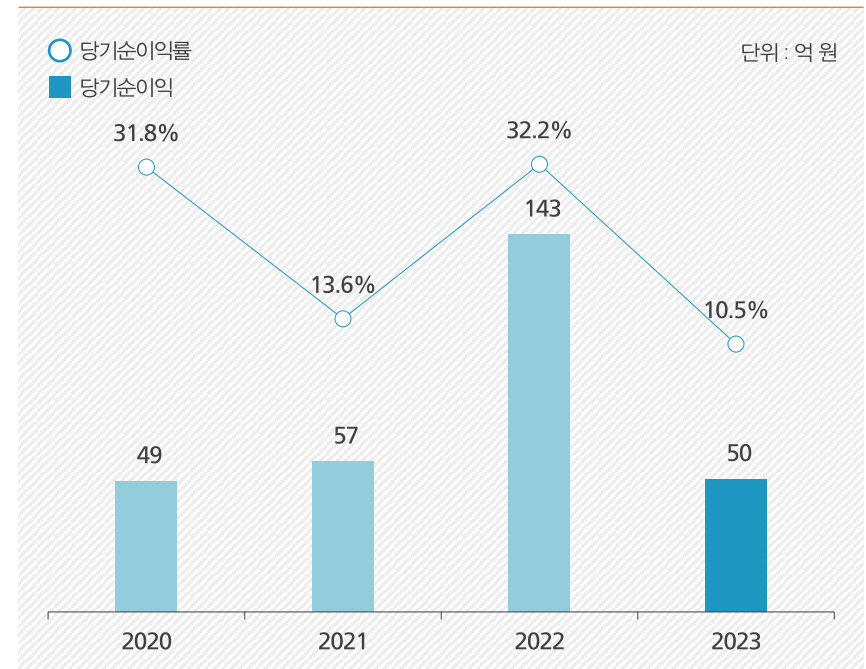
- » 영업비용 증가: M/C 등 설비 증설에 따른 감가상각비(+41.2억, +31.7%) 및 전력비 증가. 9월부터 M/C 일부 매출 발생
- » 조달비용 증가: 금리 인상에 따른 이자비용(+16.3억, +73.3%) 증가.
- » 일시적 영업외 비용 발생: 상장에 따른 CB평가손실(36.8억) 및 외화에 대한 환율변동으로 인한 감소 효과(22.5억) 발생

영업이익(률)



주: K-IFRS 연결 기준

당기순이익(률)





재무상태표

단위 : 백만 원

구분	2021	2022	2023	2Q2024
유동자산	10,129	13,508	21,743	28,196
비유동자산	102,603	170,372	176,290	183,518
자산총계	112,732	183,880	198,033	211,715
유동부채	17,708	62,708	31,718	37,069
비유동부채	39,175	51,819	58,634	67,596
부채총계	56,882	114,527	90,352	104,665
자본금	3,781	3,781	4,480	4,480
자본잉여금	24,459	24,459	57,822	64,598
자본조정	-984	-984	-984	-2,964
기타포괄손익 누계액	7,643	6,425	4,892	4,620
이익잉여금	19,677	34,922	40,892	35,748
자본총계	55,849	69,353	107,681	107,050

KIFRS 연결 기준

손익계산서

단위 : 백만 원

구분	2021	2022	2023	2Q2024
매출액	41,842	44,319	47,688	18,303
매출원가	32,577	31,969	37,498	21,186
매출총이익	9,265	12,350	10,190	-2,883
판매관리비	3,673	4,324	5,294	2,444
영업이익	5,592	8,026	4,895	-5,327
금융수익	3,156	3,383	812	328
금융비용	3,760	2,846	8,068	2,631
기타수익	613	2,221	3,609	713
기타비용	25	-	1,576	8
법인세비용차감전 순이익	5,576	10,784	-329	-6,925
법인세비용	-106	-3,476	-5,351	-2,393
당기순이익	5,682	14,260	5,023	-4,532